

次世代の回路パターン形成に対応した直接描画装置を発売

～世界最高レベルの高精細描画と高生産性を実現～

株式会社SCREEN PE ソリューションズはこのほど、独自開発の高精細露光エンジンを搭載したプリント基板回路パターン用直接描画装置「LANZAN」を開発。6月6日（水）から8日（金）まで東京・有明の東京ビッグサイトで開催される「JPCA Show 2018（第48回国際電子回路産業展）」に出展します。

LANZAN

☆この画像の印刷用データ(解像度300dpi)は、
下記URLよりダウンロードできます。

(www.screen.co.jp/press/download/PE180531.zip)

販売開始予定	2018年6月
年間販売予定台数（初年度）	12台



近年、スマートフォン市場では高機能化が加速し、有機ELパネルの採用やバッテリーの大型化、高周波対応などを受け、メイン基板の小型化と微細化がより一層進むと予想されています。そのため、回路パターンの形成工程においては、これまで主流となっていた「サブトラクティブ法^{※1}」では対応が困難になってきており、「MSAP (Modified Semi Additive Process) 法^{※2}」へのシフトが進んでいます。現在、MSAP法の主流は60 μ mピッチですが、40 μ mピッチにまで高精細化が進むといわれており、直接描画装置にはさらなる高精細な描画性能が求められています。

このような動向を背景に当社は、次世代MSAP法による回路形成の量産に対応した直接描画装置「LANZAN」を開発しました。「LANZAN」は、独自開発の広角高精細露光エンジンを搭載し、ワンパスで線幅8 μ mレベルの高精細回路パターンの高速描画が可能。また、高い描画位置精度 ($\pm 7\mu$ m) を誇るアライメント技術により、ノンストップで撮像できます。さらに、オートフォーカスやメカニカルクランプ^{※3}をはじめ、最高水準の描画品質を支える数々の機能を備えるなど、世界最高レベルの高精細描画と高生産性を実現する装置となっています。

当社は、全世界で累計460台以上の納入実績を持つプリント基板ソルダーレジスト用直接描画装置「Lediaシリーズ」に加え、回路パターン用露光に特化した今回の「LANZAN」をラインアップすることにより、プリント基板業界のさまざまなニーズに応えていきます。

- ※1 基板全面を覆った導体の非回路部分だけをエッチングで除去し、回路パターンを形成する方法
- ※2 銅箔付きの絶縁樹脂を使用しためっき工法によって、回路パターンを形成する方法
- ※3 基板の反りを抑制するために、基板端部を機械的に押さえる機構

● 本件についてのお問い合わせ先

株式会社SCREEN PE ソリューションズ ビジネス統轄部 営業部 Tel: 075-417-2704 pe-info@screen.co.jp